

Heißluft-SMD-Reworkstation mit Vakuum - Hakko FR-810B

Artikel-Nr. **HK-FR-810B-15** Hersteller **Hakko**
Hersteller-Nr. **FR 810B-15** EAN **4962615047039**

Professionelle 670W-Heißluft-SMD-Reworkstation mit großvolumigem Luftstrom, Vakuum-Aufnahmefunktion und Aufnahmeanzeige für die sichere Entnahme von Bauteilen. Reduziert die Rework-Zeit auf ein Drittel gegenüber herkömmlichen Modellen.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Leistung	820 W
Temperatur (max.)	über 550 °C
Temperaturbereich	50-600 °C
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85151990



LEISTUNG

820 W

TEMPERATURBEREICH

50-600 °C

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Übersicht

Die Hakko FR-810B ist eine leistungsstarke Heißluft-SMD-Reworkstation für das effiziente Entfernen und Ersetzen oberflächenmontierter Bauteile auf Leiterplatten mit hoher Wärmekapazität. Mit 670W Leistung und großvolumigem Luftstrom bietet sie eine hervorragende Heizleistung und reduziert zugleich die thermische Belastung von Leiterplatten und Bauteilen.

Hauptmerkmale

- Hohe Leistung von 670W mit großvolumiger Heißluftabgabe für ein schnelles Aufheizen der Bauteile
- Vakuum-Aufnahmefunktion mit integriertem Saugnapf für ein sicheres, beschädigungsfreies Entnehmen von Bauteilen
- Aufnahmeanzeige zur voreingestellten Vakuumaktivierung nach dem Schmelzen der Lötstelle
- Fortschrittliches Düsendesign mit internen Luftöffnungen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung durch Konvektion
- Chain-Presets-Funktion für eine vereinfachte Programmierung von Temperaturprofilen
- Reduziert die Rework-Zeit auf etwa ein Drittel gegenüber herkömmlichen Heißluftstationen
- Minimiert die thermische Belastung von Leiterplatten und benachbarten Bauteilen

Technische Daten

Leistung	670W
Luftstrom	Großes Volumen (Spezifikationen im Handbuch verfügbar)
Vakuum-Aufnahmefunktion	Ja, mit Aufnahmeanzeige
Düsentyp	Mehrere Optionen, einschließlich BGA-Düsen mit verbesserten Temperatureigenschaften
Herkunftsland	Japan

Anwendungen

Ideal für SMD-Rework, den Austausch von BGA-Bauteilen, die Reparatur von Leiterplattenbestückungen mit hoher Packungsdichte und die thermische Profilierung von Platinen mit hoher Wärmekapazität. Geeignet für professionelle Elektronik-Reparaturwerkstätten, Fertigungsbetriebe und anspruchsvolle Hobbyanwendungen.

Lieferumfang

Umfasst das Heißluft-Handstück, Düsen, den Vakuum-Aufnahmesauger sowie Zubehör gemäß Packliste. Bedienungsanleitung und Broschüre stehen bei Hakko zum Download bereit.